苏州和林微纳科技股份有限公司

公司代码:688661 公司简称:和林微纳

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本151,887,826股,以此计算合计拟派发现金红利1,215.10万元(含税)。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	和林微纳	688661	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵川	赵书洁
联系地址	苏州高新区普陀山路196号	苏州高新区普陀山路196号
电话	0512-87176306	0512-87176306
传真	0512-87176310	0512-87176310
电子信箱	zqb@uigreen.com	zqb@uigreen.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务,主要产品或服务情况

和林微纳是一家以微型精密制造为底层技术的国家高新技术企业,深耕于MEMS微机电、半导体芯片测试及微型传动领域,公司产品主要包括MEMS精微电子零部件系列产品,半导体芯片测试探针系列产品以及微型传动系统系列产品。在半导体芯片测试探针领域,公司已经成为了国际知名芯片及半导体封测厂商的探针供应商,是国内同行业中竞争实力较强的企业之一。在微机电(MEMS)精微电子零组件领域,公司通过积极参与国际竞争成功进入国际先进MEMS厂商供应链体系并积累了优质的客户资源。在微型传动领域,公司专注于清洁机器人传动系统及相关产品的研发、生产和销售,致力于为客户提供高效、智能的清洁传动解决方案。

图:和林微纳的主要产品及应用领域

2.2 主要经营模式

公司所处行业的经营模式主要包括产业链供应模式以及VMI(寄售)业务合作模式。在产业链供应模式下,公司主要与部分终端品牌厂商以及组件厂商共同设计、开发精微电子零组件产品,并向组件厂商供应产品;在VMI业务模式下,供应商需要根据合同约定为客户供应不低于最低标准库存的货物,客户从库存中领用产品后根据实际领用情况与供应商结算货款。

(1)研发模式

公司紧跟行业发展步伐,从新产品、新工艺、新应用三个方面进行布局,重视自主创新和产学研深度合作相结合,坚持技术创新、成果转化、工艺优化,保证公司产品的竞争优势和可持续发展;在掌握行业核心关键技术的基础上,不断结合自身业务发展需要,通过持续的自主研发与合作,不断拓展产品业务的应用领域,建立以“企业为主体、市场为导向、客户需求为目标”的技术研发体系。提升研发平台的技术开发能力和市场反应速度,在提高产品使用性能和工作效率的基础上能有效降低生产成本,使主营业务的产品和服务具有市场竞争力。

(2)采购模式

公司主要采取“按需采购、以产定购”的采购模式,从需求管理、战略寻源、采购执行到供应商生命周期管理,为公司提供准时、优质、低成本的物料和服务。采购部门会持续对公司生产经营所需的主要原辅材料价格波动趋势、供求关系等进行预判,适时采取战略储备或去库存的策略,来保障公司经营竞争力。日常采购中持续推进标准化工作,规范物料描述,对主要标准性物料及设备的采购,通过招标平台建设,采取多种采购策略来达成采购目标,提升先进性、可靠性及成本优势等竞争力。

(3)生产模式

公司主要采取“以销定产”“定制生产”的形式来满足客户需求,对优质客户的需求提供适量备货生产管理。在部分定制化产品的开发中,公司派出技术人员参与组件厂商或部分终端品牌厂商的前端产品设计,并与客户的开发人员共同制定产品的技术标准和生产方案;方案通过评估后,公司安排进行模具设计以及产品的试生产;在试生产经客户认可后,公司开始为客户批量供应相关产品。公司全面实施ISO9001及IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO50001能源管理体系,持续推进技术创新、工艺创新、设备创新,并辅以精益管理,使产品的制造过程做到质量稳定、制造成本最优、产品交付准时、安全环保节能。

(4)销售模式

公司坚持以客户为中心,以终端客户认证带动销售,全方位深入客户,挖掘客户的需求和技术趋势,强调产品差异化,实出技术优势,通过精准营销和用户反馈优化产品设计为客户提供多样化的产品应用解决方案。持续推进大客户战略,锁定业内前头部VCM/MEMS终端客户,和区域头部设计公司合作,从设计端切入,为客户提供测试技术支持和售后服务,集中优质资源全方位服务好客户,提高客户黏性,战略客户销售占比逐年上升,大大提升了公司在行业、市场中的地位。为加速开发终端客户、更好地服务属地客户,公司在中国香港、日本、瑞士、美国等地新设了境外子公司或营销网络,积极开拓海外市场。

2.3 所处行业情况

(1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司是一家国家级高新技术企业,长期深耕半导体芯片测试及MEMS精微零组件领域,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(分类代码:C39);根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司属于“1.2电子核心产业”中的“1.2.1新型电子元器件及设备制造”。

①半导体芯片测试行业

半导体测试是半导体生产工艺的重要环节,由于半导体生产过程具有极高的精密性,任何轻微的工序差错都可能导致产品失效,因此测试环节重要性彰显无遗。

半导体芯片的测试主要可分为三个阶段:芯片设计中的设计验证,即描述、调试和检验新的芯片设计,保证符合规格要求;晶圆制造中的晶圆测试(CP)以及封装完成后的成品测试(FT),通过分析测试数据,能够确定具体失效原因,并改进设计及生产、封测工艺,以提高良率及产品质量。无论哪个阶段,要测试芯片的各项功能指标必须完成两个步骤,一是将芯片的引脚与测试机的功能模块连接,二是要通过测试机对芯片施加输入信号,并检测芯片的输出信号,判断芯片功能和性能指标的有效性。在芯片测试过程中,探针用于连接测试机与芯片,来检测芯片的电路、功能和老化等性能指标,其品质的优劣对芯片的测试效果、生产效率以及生产成本控制都有着重要的影响,是半导体封装与检测中需要使用的重要耗材。

图:集成电路测试贯穿于集成电路产业链的各个环节 来源:国金证券

测试探针是半导体芯片测试过程中的关键耗材,用于晶圆、芯片引脚或锡球与测试机之间的精密连接,实现信号传输以检测产品的导通、电流、功能和老化情况等性能指标。在芯片封装前,CP测试主要用于挑选出有缺陷的裸芯片,以降低后续封装和成品测试的成本,需使用测试机、探针台和探针卡,探针位于探针卡中。封装后的FT测试则确保芯片符合交付标准,防止不合格芯片流入下游,测试设备包括测试机、分选机和测试座,探针位于测试座中。

图:探针卡 来源:国金证券 图:IC测试座结构示意图 来源:国金证券

②MEMS行业

MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)即微电子机械系统,通过将微传感器、微执行器、微电源、机械结构、信号处理、控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等子系统集成在一个微米甚至纳米级的器件上,从而达到电子产品的微型化、智能化、低成本、低能耗、易于集成和高可靠性。

图:MEMS工作原理 来源:前瞻产业研究院

MEMS产品通常可分为MEMS执行器和MEMS传感器,其中传感器的市场占比约为70%左右。MEMS执行器主要负责接收电信号并将其转化为微动作,常见MEMS执行器包括微电动机、微开关等;MEMS传感器是一种检测装置,将感受到的信息按规律变换成电信号或其他形式的信息输出,常见的MEMS传感器包括惯性传感器、压力传感器、声学传感器、环境传感器以及光学传感器等。

(2)行业发展现状

①公司所处半导体芯片测试行业发展情况

近年来,随着国内经济结构转型升级、生成式人工智能出现,智能便捷的应用迅速成为市场关注的焦点,全球各大科技厂商先后进入,数字经济时代迎来新的发展机遇。大模型参数数量大、训练数据量大、模型复杂度高等特征对计算资源需求不断加强,高性能计算能力、大量存储空间、快速信息传输成为大模型训练和运行的计算核心要素,加大了对高性能半导体产品需求。

过去,CPU、GPU、AI芯片、FPGA等高算力芯片的性能提升主要依靠晶圆制造技术的进步,但是随着摩尔定律逼近极限,通过制程推进持续提升芯片性能的难度快速增加。芯粒多芯片集成封装技术能够突破单芯片集成下加工尺寸、功耗墙、内存墙等的限制,可以持续提升芯片系统的性能,是后摩尔时代持续发展高算力芯片的有效方式,已经成为高算力芯片必需的封装技术,是构建支撑算力基础设施的高算力芯片完整供应链的关键环节。

● 测试环节贯穿半导体生产制造,制程检测对芯片良率至关重要

半导体工艺制程越来越复杂,检测设备愈发重要。随摩尔定律的进一步发展,半导体芯片晶体管密度越来越高,相关产品复杂度及集成度呈现指数级增长。新应用需求驱动了制程微缩和三维结构的升级,使得工艺步骤大幅提升,成熟制程(以45nm为例)工艺步骤数大约需要430道,到了先进制程(以5nm为例)将会提升至1250道,工艺步骤将近提升了3倍;在数千道制程中,每一道制程的检测对芯片的良率起到至关重要的作用。

● Chiplet新技术及自主可控产业趋势共同驱动我国半导体测试行业快速成长

Chiplet(芯粒)的加速发展拉动测试服务需求,自主可控趋势推动半导体国产化进程加速,双重驱动下,我国半导体测试厂商将深度受益Chiplet新技术以及国产化替代打开的巨大市场空间。Chiplet相比传统SoC芯片优势明显。Chiplet能利用最合理的工艺满足数字、射频、模拟、I/O等不同模块的技术要求,把大规模的SoC按照功能分解为模块化的芯粒,在保持较高性能的同时,大幅度降低了设计复杂程度,有效提高了芯片良率、集成度,降低芯片的设计和制造成本,加速了芯片迭代速度。Chiplet技术的兴起将拉动测试产业整体需求。在CP测试环节,因为Chiplet封装成本高,为确保良率、降低成本,需要在封装前对每一颗芯片进行CP测试,相较于SoC,Chiplet对芯片的CP测试需求按照芯片裸片数量成倍增加;在FT测试环节,随着Chiplet从2D逐渐发展到2.5D、3D,测试的难度提升,简单测试机减少,复杂测试机增加。

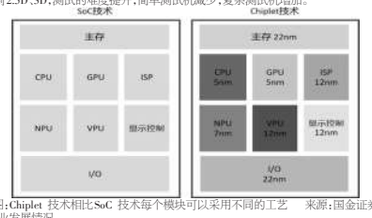

图:Chiplet 技术相比SoC 技术每个模块可以采用不同的工艺 来源:国金证券

③公司所处MEMS行业发展情况

随着物联网、云计算、大数据等高新科学技术的日益成熟,传统传感器由于体积较大、集成度低等劣势,已逐渐无法满足下游行业的需求。在此背景下,MEMS技术在传感器行业的运用日益提升,行业规模也得以迅速扩张。根据Yole Group的《Status of the MEMS Industry 2025》行业报告显示,2024年全球MEMS行业收入达到154亿美元,在各终端市场大趋势推动下,到2030年市场规模有望达到192亿美元,年复合增长率为3.7%。据Global Info Research发布的报告称,2025-2031年全球MEMS传感器市场将保持7.6%的CAGR增长,增长动力主要来自三方面:一是新能源汽车渗透率提升带动车载MEMS需求(如压力传感器、惯性传感器);二是工业物联网推动工厂自动化场景的传感器部署;三是消费电子高端化(如折叠屏手机、智能穿戴)催生新型MEMS产品需求。

目前,MEMS传感器已经广泛运用于消费电子、汽车、工业、医疗、通信等各个领域,随着人工智能和物联网技术的发展,MEMS传感器的应用场景将更加多元。人工智能方面,随着下游行业对传感器数据收集的精确性提出更高要求,MEMS传感器已逐渐成为人工智能的重要底层硬件之一。物联网方面,系统复杂程度的提升、结点数量的增长也将要求更多的传感器数量以及更高的智能化程度。未来,随着医疗、人工智能、物联网、智慧城市等应用领域智能现代化趋势日益明显,MEMS传感器将迎来更广阔的发展空间。

(2)、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是全球微纳米制造解决方案供应商之一,提供涵盖微机电系统(“MEMS”)微纳米制造元件、半导体测试探针及微型传动系统的全面产品组合。公司自2008年进入微纳米制造行业,在MEMS精微电子零组件领域,已进入国际主流MEMS厂商供应链体系。在微机电(MEMS)精微电子零组件领域,公司通过积极参与国际竞争成功进入国际先进MEMS厂商供应链体系并积累了优质的客户资源;在声学传感器领域,本公司不仅凸据了显著的市场地位并拥有可观的市场份额,而且在光学传感器结构件领域也积累了突破性的技术成果,成功跻身行业领军客户的优选供应商之列。在半导体芯片测试探针领域,公司凭借卓越的技术和出色的服务,已成功跻身众多国际知名芯片及半导体封测厂商的探针供应商行列,在继续保持MEMS精微屏蔽罩及现有半导体测试探针产品优势的同时,公司成功针对半导体基板测试线针(替代进口)、半导体前道晶圆测试探针卡,后道测试界面连接系统方案,机器人微型精密传动系统和微型精密手机光学驾组件的布局。截至2025年末,公司2021年度定增募投项目中的“基板级测试探针研发量产项目”已完成建设并结项,目前正处于产品性能优化与产能爬坡阶段。此外,公司在机器人微型精密传动系统和微型精密手机光学驾组件领域也完成了前期业务布局,相关产品已在清洁机器人等智能设备等应用领域实现交付。公司依托全球化服务网络及国家级专精特新“小巨人”企业的技术平台,持续配合半导体芯片产业链的国产化进程。

(3)、报告期内新技术、新产业、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)公司所处半导体芯片测试行业发展情况及未来发展趋势

半导体测试探针是半导体制造过程中用于电性能测试的关键组件,通过与芯片焊盘接触实现信号传输,直接影响芯片良率与测试效率。作为半导体产业链“卡脖子”环节之一,其技术精度(如接触电阻、寿命)直接决定高端芯片的测试可靠性。根据QYResearch最新调研报告显示,2024年全球半导体测试探针市场规模达6.52亿美元,预计2031年将增至14.75亿美元,2025-2031年CAGR为12.5%,成为半导体设备国产化替代的重要赛道。

2025年全球半导体产业正处于新一轮高景气周期,根据美国半导体行业协会(SIA)统计,2025年全球半导体销售额达到7917亿美元,同比增长25.6%,创历史新纪录,2026年有望进一步攀升至约1万亿美元。此前世界半导体贸易统计组织(WSTS)曾预计2025年全球半导体销售额将约为7000亿美元,实际增速远超预期,数据中心对新型计算芯片的巨大需求是核心推动力。

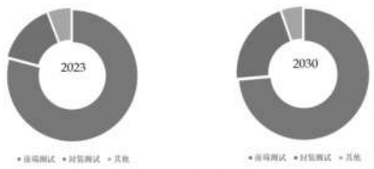

图:全球芯片封装测试探针市场规模按应用细分

来源:QYResearch“全球芯片封装测试探针市场研究报告2024-2030”

在半导体产业的复苏进程中,新一代技术的推动以及新兴应用市场的不断涌现,为产业发展注入了强劲动力。这些新兴应用市场涵盖AI及其驱动的新智能应用、AI PC、AI手机、新能源汽车以及工业4.0应用等多个领域。随着我国“十四五”规划明确将半导体测试设备列为重点发展领域,通过税收减免、研发补贴(如国家大基金投资)支持企业突破高端探针技术。国内企业持续加大对半导体行业的资金投入,全力支持国产化进程,半导体产业的发展环境得以显著优化。根据QYResearch预测,2031年全球市场规模将达14.75亿美元,分区域看:亚太/亚洲是半导体产能转移,2025-2031年CAGR达14%,中国占比将提升至25%(2024年为19%)。

未来,在国产替代的浪潮推动下,本土晶圆产线建设的持续推进、封测行业的快速发展、先进制程对探针数量需求的持续增长、工业4.0理念的广泛传播以及人工智能技术带动的芯片需求增加与性能提升等多重因素,将进一步推动我国半导体测试探针的发展。公司也将聚焦高频、微型化探针研发,加速开拓东南亚、中东、东欧市场,降低对单一市场依赖,坚持以供应链韧性为基础,以技术创新为引擎,以合规经营为保障,推动公司在全球高端测试设备竞争中占据一席之地。

(2)公司所处MEMS行业发展情况及未来发展趋势

随着万物互联与人工智能的兴起,作为集成电路细分行业的MEMS获得了更广阔的市场空间和业务机会。目前,MEMS器件已经成为日常生活中不可或缺的一部分,嵌入在智能手机、汽车和可穿戴设备等各种系统中,智加手机中的MEMS硅麦克风、汽车中的气囊检测传感器等。由于MEMS器件多样化的应用,使全球MEMS市场连续多年快速增长,其数量和相关收入都相当可观。

根据Yole发布的《MEMS产业现状-2025版》报告显示,全球MEMS市场规模将由2024年的154亿美元增长至2030年的192亿美元,CAGR(年均复合增长率)为3.7%。

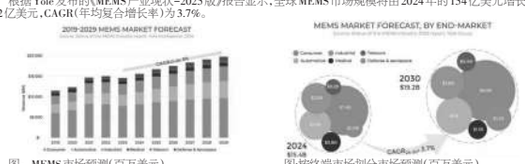

图:MEMS市场预测(百万美元) 图:按终端市场划分市场预测(百万美元)

来源:Yole

在智能化加速和万物互联的时代,应用场景多元化,MEMS行业规模不断扩大,行业发展需要更精准可靠的传感,MEMS产品也将不断向微型化和高集成化的发展趋势迈进,多传感器的融合和协同未来将进一步广泛应用于复杂工业过程控制、机器人、智慧交通、海洋监视和管理、智慧农业、遥感、医疗诊断等诸多领域,成为传感器产业未来主要发展趋势之一。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	147,589.119287	140,806.82	4.82	137,837.92
归属于上市公司股东的净资产	122,778.406763	120,867.94	1.58	122,455.88
营业收入	86,755.955036	56,901.092831	52.47	28,574.83
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	85,155.41	55,940.05	52.23	28,206.62
利润总额	2,631.519103	-1,690.46224	不适用	-3,437.57
归属于上市公司股东的净利润	2,979.181426	-870.808057	不适用	-2,093.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,506.03	-1,988.33	不适用	-3,553.05
经营活动产生的现金流量净额	7,531.491435	1,405.123094	436	-1,105.72
加权平均净资产收益率(%)	2.45	-0.72	不适用	-1.69
基本每股收益(元/股)	0.1961	-0.0573	不适用	-0.1378
稀释每股收益(元/股)	0.1961	-0.0573	不适用	-0.1376
研发投入占营业收入的比例(%)	7.30	10.01	减少2.71个百分点	25.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	20,877.09	23,080.80	23,956.74	18,841.33
归属于上市公司股东的净利润	2,654.74	413.84	609.41	-698.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,472.74	361.79	498.43	-826.93
经营活动产生的现金流量净额	1,181.92	4,487.82	142.06	1,719.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,831
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,161
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
骆兴顺	-1,515,537	50,623,757	33.33	0	无	0	境内自然人
钱晓晟	-1,950,000	11,232,000	7.39	0	无	0	境内自然人
马洪伟	-520,000	7,886,112	5.19	0	无	0	境内自然人
苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)	-959,140	7,152,860	4.71	0	无	0	境内非国有法人
余方标	-529,684	4,222,015	2.78	0	无	0	境内自然人
崔连军	-905,500	3,950,000	2.60	0	无	0	境内自然人
江晓燕	-474,603	2,385,397	1.57	0	无	0	境内自然人
罗耘天	-303,415	1,685,585	1.11	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	448,461	1,578,932	1.04	0	无	0	其他
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	779,037	1,321,137	0.87	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)骆兴顺担任苏州和阳的普通合伙人;崔连军为骆兴顺的外甥;江晓燕与罗耘天为母子关系; (2)未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本节“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2026-010

苏州和林微纳科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提醒:

● 本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议

● 本次预计的关联交易属于苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或)日常关联交易,是公司日常业务发展需要,符合公司和股东的利益。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则进行,不影响公司的独立性,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月30日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年3月30日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交2025年年度股东会审议。

董事会审计委员会认为:公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2026年初至2026年3月29日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江苏普诺威电子股份有限公司	1000	1.72	80.6	465.44	0.80	预计本年度相关业务有所增长
向关联人销售产品	江苏普诺威电子股份有限公司	200	0.20	0	9.00	0.02	预计本年度相关业务有所增长
合计	-	1200	-	80.6	474.44	-	-

注:1、本次日常关联交易预计额度授权有效期自董事会审议通过之日起至下一年度日常关联交易预计议案被审议通过之日止;

2、以上数据均为含税数据,上年实际发生金额经审计,本次预计金额未经审计;

3、“占同类业务比例”计算基数为公司最近一期经审计的同类业务数据总额;

4、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年4月29日第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。前次关联交易情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江苏普诺威电子股份有限公司	1000	432.84	-
向关联人销售产品	江苏普诺威电子股份有限公司	200	9.00	-
合计	-	1200	441.84	-

注1:上年(前次)实际发生金额为2025年4月29日至2026年3月28日的交易金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称	江苏普诺威电子股份有限公司
企业性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	马洪伟
注册资本	14185万人民币
成立日期	2004年04月09日
注册地址	昆山市千灯镇宏洋路322号
主营业务	研发、生产、销售高密度互连印制电路板、集成电路封装载板、刚挠印制电路板;元器件贴装;货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规限定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2024年12月31日的主要财务数据(经审计)	总资产:96,436.48万元 净资产:80,301.47万元 营业收入:52,629.97万元 净利润:6701.89万元

(二)关联关系

公司董事马洪伟担任江苏普诺威电子股份有限公司董事长和总经理,为普诺威法定代表人。普诺威为公司关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备较好的履约能力。公司与关联方之间的交易将严格按照合同约定执行,合同合法有效,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联人购买原材料、销售产品等,均为公司开展日常经营活动所需。所有交易将与相应的交易方签订书面协议,各项交易根据自愿、平等、互惠互利,公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行;当交易的价格没有市场的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行,因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的,符合公司和全体股东的利益。

(二)关联交易定价的公允性及合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,遵循了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。

(三)关联交易的持续性

公司与关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。此外,公司产供销系统完整,独立,不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2026-006

苏州和林微纳科技股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.08元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股;

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持现金分红总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况;

● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形;

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,979.18万元,母公司实现的净利润为3,517.60万元。截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为9,807.93万元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本151,887,826股,以此计算合计拟派发现金红利1215.10万元(含税)。

如在上述利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	12,151,026.08	9,346,943.12	7,189,956.24
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,791,814.26	-8,708,080.57	-20,939,144.50
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	98,079,266.37		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)A	28,687,925.44		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)B	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)C	48,196.4		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)D=A+B	28,687,925.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	是		
现金分红比例(%)(E=D/C)	59,522.96%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)F	192,467,730.26		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)G	1,722,318,742.81		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)H=F/G	11.17%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于(2025年度利润分配预案)的议案》,董事会认为公司2025年年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,该方案履行了合法的决策程序,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规